

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
15. September 2005 (15.09.2005) ✓

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 2005/086233 A2**

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: **H01L 23/498, 23/538**

(21) Internationales Aktenzeichen: **PCT/EP2005/000327**

(22) Internationales Anmeldedatum:  
14. Januar 2005 (14.01.2005)

(25) Einreichungssprache: **Deutsch**

(26) Veröffentlichungssprache: **Deutsch**

(30) Angaben zur Priorität:  
102004010703.3 4. März 2004 (04.03.2004) **DE**

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): **EPCOS AG [DE/DE]; St.-Martin-Str. 53, 81669 München (DE).**

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **PAHL, Wolfgang [DE/DE]; Bavariaring 41, 80336 München (DE).**

(74) Anwalt: **EPPING HERMANN FISCHER PATENTANWALTSGESELLSCHAFT MBH; Rüdigersstr. 55, 80339 München (DE).**

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): **AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.**

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): **ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).**

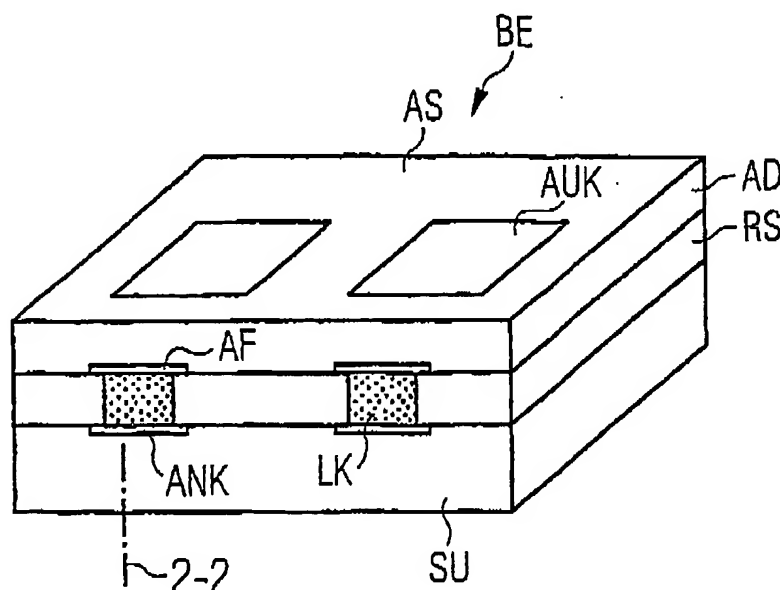
Veröffentlicht:

— ohne internationalen Rechenzeichenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: **COMPONENT WITH ENCAPSULATION SUITABLE FOR WLP AND PRODUCTION METHOD**

(54) Bezeichnung: **BAUELEMENT MIT WLP-FÄHIGER VERKAPSELUNG UND HERSTELLVERFAHREN**



(57) Abstract: The invention relates to an electrical component, with a cover and in particular with a circuit board, for encapsulation, with electrical connections made from a conducting glue. The above can be injected into the construction through a channel system, whereby the electrical short-circuiting of all connections produced can be broken again by means of a suitably executed cutting step in the separation of the components.

(57) Zusammenfassung: Es wird vorgeschlagen, ein elektrisches Bauelement mit einer Abdeckung und insbesondere mit einer Leiterplatte zu verkapseln und die elektrischen Verbindungen mithilfe eines Leitlebers herzustellen. Dieser kann durch ein Kanalsystem in den Aufbau eingespritzt werden.

wobei der elektrische Kurzschluss aller Verbindungen durch einen geeignet geführten Sägeschnitt beim Vereinzeln der Bauelemente wieder aufgetrennt werden kann.

**BEST AVAILABLE COPY**

**WO 2005/086233 A2**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

*Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.*

**BEST AVAILABLE COPY**